

LAMINATED CERAMIC ELECTRONIC COMPONENT AND ITS MANUFACTURING METHOD AND CERAMIC PASTE AND ITS MANUFACTURING METHOD

Patent number: JP2001237140 (A)

Publication date: 2001-08-31

Inventor(s): MIYAZAKI MAKOTO; TANAKA SATORU

Applicant(s): MURATA MANUFACTURING CO

Classification:

- international: C04B35/00; B28C1/16; B28C7/02; C04B35/622; H01F17/00; H01F41/04; H01G4/12; H01G4/30; C04B35/00; B28C1/00; B28C7/00; C04B35/622; H01F17/00; H01F41/04; H01G4/12; H01G4/30; (IPC1-7): H01G4/12; B28C1/16; B28C7/02; C04B35/495; C04B35/622; H01F17/00; H01F41/04; H01G4/30

- european: H01F17/00A2; H01F41/04A8; H01G4/30

Application number: JP20000319521 20001019

Priority number(s): JP20000319521 20001019; JP19990352634 19991213

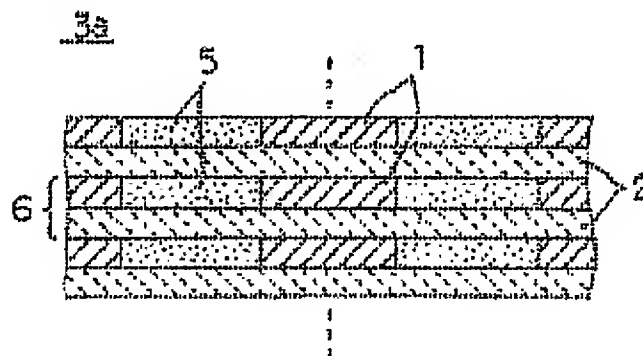
Also published as:

GB2357373 (A)
GB2357373 (B)
US2001010617 (A1)
US6808577 (B2)
TW514939 (B)

Abstract of JP 2001237140 (A)

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide ceramic paste in which the distributing properties of ceramic powder contained in the paste is improved.

SOLUTION: To manufacture ceramic paste, a primary distribution process for distributed-processing a primary mixture containing at least ceramic powder and the first organic solvent and a secondary distributing process for distributed-processing a secondary mixture in which at least an organic binder is added to the primary mixture, are performed. The primary mixture and/or the secondary mixture comprise the second organic solvent having a relative evaporation rate smaller than the first organic solvent. The first organic solvent is removed selectively by thermally treating the secondary mixture after the secondary distribution process. The ceramic paste is used advantageously for forming ceramic green layers 5 for absorbing stepped sections on the main surfaces of ceramic green sheets 2 so as to substantially remove the stepped sections by the thickness of internal electrodes 1 in a laminated ceramic capacitor.



Data supplied from the esp@cenet database — Worldwide

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2001-237140

(P2001-237140A)

(43) 公開日 平成13年8月31日 (2001.8.31)

| (51) Int.Cl. ⁷ | 識別記号 | F I | ターミナル* (参考) |
|---------------------------|----------------|----------------------|----------------|
| H 0 1 G 4/12 | 3 6 4 3 4 9 | H 0 1 G 4/12 | 3 6 4 3 4 9 |
| B 2 8 C 1/16 7/02 | | B 2 8 C 1/16 7/02 | |
| C 0 4 B 35/495 | | H 0 1 F 17/00 | D |

審査請求 未請求 請求項の数15 O L (全 17 頁) 最終頁に続く

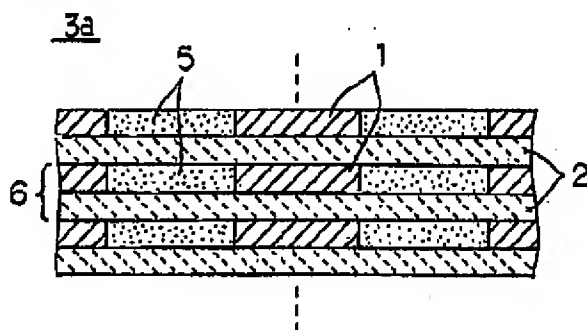
| | | | |
|--------------|-----------------------------|----------|--|
| (21) 出願番号 | 特願2000-319521(P2000-319521) | (71) 出願人 | 000006231 株式会社村田製作所 京都府長岡京市天神二丁目26番10号 |
| (22) 出願日 | 平成12年10月19日 (2000. 10. 19) | (72) 発明者 | 宮崎 信 京都府長岡京市天神二丁目26番10号 株式 会社村田製作所内 |
| (31) 優先権主張番号 | 特願平11-352634 | (72) 発明者 | 田中 覚 京都府長岡京市天神二丁目26番10号 株式 会社村田製作所内 |
| (32) 優先日 | 平成11年12月13日 (1999. 12. 13) | (74) 代理人 | 100085143 弁理士 小柴 雅昭 |
| (33) 優先権主張国 | 日本 (J P) | | |

(54) 【発明の名称】 積層型セラミック電子部品およびその製造方法ならびにセラミックペーストおよびその製造方法

(57) 【要約】

【課題】 そこに含まれるセラミック粉末の分散性が高められたセラミックペーストを提供する。

【解決手段】 セラミックペーストを製造するため、少なくともセラミック粉末と第1の有機溶剤とを含む1次混合物を分散処理する1次分散工程と1次混合物に少なくとも有機バインダを加えた2次混合物を分散処理する2次分散工程とを実施する。1次混合物および/または2次混合物は、第1の有機溶剤より相対蒸発速度が小さい第2の有機溶剤を含んでいる。そして、2次分散工程の後、2次混合物を加熱処理することによって、第1の有機溶剤を選択的に除去する。このセラミックペーストは、たとえば積層セラミックコンデンサにおける内部電極1の厚みによる段差を実質的になくすようにセラミックグリーンシート2の主面上に段差吸収用セラミックグリーン層5を形成するために有利に用いられる。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 セラミックスラリー、導電性ペーストおよびセラミックペーストをそれぞれ用意し、前記セラミックスラリーを成形することによって得られたセラミックグリーンシートと、前記セラミックグリーンシートの主面上にその厚みによる段差をもたらすように部分的に前記導電性ペーストを付与することによって形成された内部回路要素膜と、前記内部回路要素膜の厚みによる段差を実質的になくすように前記セラミックグリーンシートの前記主面上であって前記内部回路要素膜が形成されない領域に前記セラミックペーストを付与することによって形成された段差吸収用セラミックグリーン層とを備える、複数の複合構造物を作製し、複数の前記複合構造物を積み重ねることによって、生の積層体を作製し、前記生の積層体を焼成する、各工程を備える、積層型セラミック電子部品の製造方法であって、前記セラミックペーストを用意する工程は、少なくともセラミック粉末と第1の有機溶剤とを含む1次混合物を分散処理する1次分散工程と、前記1次分散工程を経た前記1次混合物に少なくとも有機バインダを加えた2次混合物を分散処理する2次分散工程と、前記第1の有機溶剤より相対蒸発速度が小さい第2の有機溶剤を前記1次混合物および／または前記2次混合物に含ませる工程と、前記2次分散工程の後、前記2次混合物を加熱処理することによって、前記第1の有機溶剤を選択的に除去する除去工程とを備える、積層型セラミック電子部品の製造方法。

【請求項2】 前記1次分散工程において、前記1次混合物は有機分散剤を含む、請求項1に記載の積層型セラミック電子部品の製造方法。

【請求項3】 前記第1の有機溶剤の20℃における相対蒸発速度は、100以上であり、前記第2の有機溶剤の20℃における相対蒸発速度は、50以下である、請求項1または2に記載の積層型セラミック電子部品の製造方法。

【請求項4】 前記セラミックペーストを用意する工程は、前記2次分散工程の後であって、前記除去工程の前に、前記2次混合物を濾過する工程をさらに備える、請求項1ないし3のいずれかに記載の積層型セラミック電子部品の製造方法。

【請求項5】 前記セラミックペーストを用意する工程は、前記有機バインダを前記第1の有機溶剤および／または前記第2の有機溶剤に溶解することによって、有機ビヒクルを作製する工程と、前記有機ビヒクルを濾過する工程とをさらに備え、前記2次混合物は、前記濾過工程を経た前記有機ビヒクルの状態に加えられた前記有機バインダを含んでいる、請求項1ないし4のいずれかに

記載の積層型セラミック電子部品の製造方法。

【請求項6】 前記第1の有機溶剤は、前記第2の有機溶剤より低い沸点を有する、請求項1ないし5のいずれかに記載の積層型セラミック電子部品の製造方法。

【請求項7】 前記第1の有機溶剤の沸点と前記第2の有機溶剤の沸点との差は、50℃以上である、請求項6に記載の積層型セラミック電子部品の製造方法。

【請求項8】 前記セラミックスラリーは、前記セラミックペーストに含まれる前記セラミック粉末と実質的に同じ組成を有するセラミック粉末を含む、請求項1ないし7のいずれかに記載の積層型セラミック電子部品の製造方法。

【請求項9】 前記セラミックスラリーおよび前記セラミックペーストにそれぞれ含まれるセラミック粉末は、ともに、誘電体セラミック粉末である、請求項1ないし8のいずれかに記載の積層型セラミック電子部品の製造方法。

【請求項10】 前記内部回路要素膜は、互いの間に静電容量を形成するように配置される内部電極であり、前記積層型セラミック電子部品は、積層セラミックコンデンサである、請求項9に記載の積層型セラミック電子部品の製造方法。

【請求項11】 前記セラミックスラリーおよび前記セラミックペーストにそれぞれ含まれるセラミック粉末は、ともに、磁性体セラミック粉末である、請求項1ないし8のいずれかに記載の積層型セラミック電子部品の製造方法。

【請求項12】 前記内部回路要素膜は、コイル状に延びるコイル導体膜であり、前記積層型セラミック電子部品は、積層インダクタである、請求項11に記載の積層型セラミック電子部品の製造方法。

【請求項13】 請求項1ないし12のいずれかに記載の製造方法によって得られた、積層型セラミック電子部品。

【請求項14】 少なくともセラミック粉末と第1の有機溶剤とを含む1次混合物を分散処理する1次分散工程と、

前記1次分散工程を経た前記1次混合物に少なくとも有機バインダを加えた2次混合物を分散処理する2次分散工程と、

前記第1の有機溶剤より相対蒸発速度が小さい第2の有機溶剤を前記1次混合物および／または前記2次混合物に含ませる工程と、

前記2次分散工程の後、前記2次混合物を加熱処理することによって、前記第1の有機溶剤を選択的に除去する除去工程を備える、セラミックペーストの製造方法。

【請求項15】 請求項14に記載の製造方法によって得られた、セラミックペースト。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】この発明は、積層型セラミック電子部品およびその製造方法ならびにセラミックペーストおよびその製造方法に関するもので、特に、セラミック層間に形成される内部回路要素膜の厚みに起因する段差を吸収するために内部回路要素膜パターンのネガティブパターンをもって形成された段差吸収用セラミック層を備える、積層型セラミック電子部品およびその製造方法、ならびに、段差吸収用セラミック層を形成するのに有利に用いられるセラミックペーストおよびその製造方法に関するものである。

【0002】

【従来の技術】たとえば積層セラミックコンデンサのような積層型セラミック電子部品を製造しようとするとき、複数のセラミックグリーンシートが用意され、これらセラミックグリーンシートが積み重ねられる。特定のセラミックグリーンシート上には、得ようとする積層型セラミック電子部品の機能に応じて、コンデンサ、抵抗、インダクタ、バリスタ、フィルタ等を構成するための導体膜、抵抗体膜のような内部回路要素膜が形成されている。

【0003】近年、移動体通信機器をはじめとする電子機器は、小型化かつ軽量化が進み、このような電子機器において、たとえば積層型セラミック電子部品が回路素子として用いられる場合、このような積層型セラミック電子部品に対しても、小型化および軽量化が強く要求されるようになってきている。たとえば、積層セラミックコンデンサの場合には、小型化かつ大容量化の要求が高まっている。

【0004】積層セラミックコンデンサを製造しようとする場合、典型的には、誘電体セラミック粉末、有機バインダ、可塑剤および有機溶剤を混合してセラミックスラリーを作製し、このセラミックスラリーを、剥離剤としてのシリコン樹脂等によってコーティングされた、たとえばポリエステルフィルムのような支持体上で、ドクターブレード法等を適用して、たとえば厚さ数10 μ mのシート状となるように成形することによって、セラミックグリーンシートが作製され、次いで、このセラミックグリーンシートが乾燥される。

【0005】次に、上述したセラミックグリーンシートの主面上に、互いに間隔を隔てた複数のパターンをもって、導電性ペーストをスクリーン印刷によって付与し、これを乾燥することにより、内部回路要素膜としての内部電極がセラミックグリーンシート上に形成される。図7には、上述のように複数箇所に分布して内部電極1が形成されたセラミックグリーンシート2の一部が平面図で示されている。

【0006】次に、セラミックグリーンシート2が支持体から剥離され、適当な大きさに切断された後、図6に一部を示すように、所定の枚数だけ積み重ねられ、さらに、この積み重ねの上下に内部電極を形成していないセ

ラミックグリーンシートが所定の枚数だけ積み重ねられることによって、生の積層体3が作製される。

【0007】この生の積層体3は、積層方向にプレスされた後、図8に示すように、個々の積層セラミックコンデンサのための積層体チップ4となるべき大きさに切断され、次いで、脱バインダ工程を経た後、焼成工程に付され、最終的に外部電極が形成されることによって、積層セラミックコンデンサが完成される。

【0008】このような積層セラミックコンデンサにおいて、その小型化かつ大容量化に対する要求を満足させるためには、セラミックグリーンシート2および内部電極1の積層数の増大およびセラミックグリーンシート2の薄層化を図ることが必要となってくる。

【0009】しかしながら、上述のような多層化および薄層化が進めば進むほど、内部電極1の各厚みの累積の結果、内部電極1が位置する部分とそうでない部分との間、あるいは、内部電極1が積層方向に比較的多数配列されている部分とそうでない部分との間での厚みの差がより顕著になり、たとえば、図8に示すように、得られた積層体チップ4の外観に関しては、その一方主面が凸状となるような変形が生じてしまう。

【0010】積層体チップ4において図8に示すような変形が生じていると、内部電極1が位置していない部分あるいは比較的小数の内部電極1しか積層方向に配列されていない部分においては、プレス工程の際に比較的大きな歪みが生じたり、また、セラミックグリーンシート2間の密着性が劣っているため、焼成時に引き起こされる内部ストレスによって、デラミネーションや微小クラック等の構造欠陥が発生しやすい。

【0011】また、図8に示すような積層体チップ4の変形は、内部電極1を不所望に変形させる結果を招き、これによって、ショート不良が生じることがある。

【0012】このような不都合は、積層セラミックコンデンサの信頼性を低下させる原因となっている。

【0013】上述のような問題を解決するため、たとえば、図2に示すように、セラミックグリーンシート2上の内部電極1が形成されていない領域に、段差吸収用セラミックグリーン層5を形成し、この段差吸収用セラミックグリーン層5によって、セラミックグリーンシート2上での内部電極1の厚みによる段差を実質的になくすることが、たとえば、特開昭56-94719号公報、特開平3-74820号公報、特開平9-106925号公報等に記載されている。

【0014】上述のように、段差吸収用セラミックグリーン層5を形成することによって、図1に一部を示すように、生の積層体3aを作製したとき、内部電極1が位置する部分とそうでない部分との間、あるいは内部電極1が積層方向に比較的多数配列されている部分とそうでない部分との間での厚みの差が実質的に生じなくなり、図3に示すように、得られた積層体チップ4aにおい

て、図8に示すような不所望な変形が生じにくくなる。

【0015】その結果、前述したようなデラミネーションや微小クラック等の構造欠陥および内部電極1の変形によるショート不良といった問題を生じにくくすることができ、得られた積層セラミックコンデンサの信頼性を高めることができる。

【0016】

【発明が解決しようとする課題】上述した段差吸収用セラミックグリーン層5は、セラミックグリーンシート2の場合と同様の組成を有し、誘電体セラミック粉末、有機バインダ、可塑剤および有機溶剤を含むセラミックペーストを付与することによって形成されるが、たとえば厚み2 μ m以下といった内部電極1と同程度の厚みを有するように、段差吸収用セラミックグリーン層5を高精度に印刷等によって形成するためには、セラミックペースト中におけるセラミック粉末の分散性を優れたものとしなければならない。

【0017】これに関連して、たとえば特開平3-74820号公報では、セラミックペーストを得るため、3本ロールによる分散処理が開示されているが、このような単なる3本ロールによる分散処理では、上述したような優れた分散性を得ることが困難である。

【0018】他方、特開平9-106925号公報では、セラミックグリーンシート2のためのセラミックスラリーを、誘電体セラミック粉末と有機バインダと低沸点の第1の有機溶剤とを混合することにより作製し、これをセラミックグリーンシート2の成形のために用いるとともに、このセラミックスラリーに対して、上述の第1の有機溶剤の沸点より高沸点の第2の有機溶剤を加えて混合した後、加熱し、低沸点の第1の有機溶剤を高沸点の第2の有機溶剤に置換することにより、段差吸収用セラミックグリーン層5のためのセラミックペーストを作製することが記載されている。

【0019】したがって、上述したようにして得られたセラミックペーストにおいては、少なくとも2回の混合工程が実施されるので、セラミック粉末の分散性はある程度改善されるが、これらの混合工程では、いずれも、有機バインダを含んだ状態で実施されるため、混合時のスラリーまたはペーストの粘度は高く、たとえばボールミルのようなメディアを使った分散処理機では、セラミック粉末の分散性を優れたものとするには限界がある。

【0020】このように、内部電極1の厚みと同等の厚みを有する段差吸収用セラミックグリーン層5といった極めて薄いセラミック層を形成するために用いるセラミックペーストとしては、そこに含まれるセラミック粉末に関して優れた分散性が要求され、このような優れた分散性に対する要求は、内部電極1の厚みが薄くなるほど厳しくなる。

【0021】また、段差吸収用セラミックグリーン層5

におけるセラミック粉末の分散性が仮に悪い場合であっても、その上に重ねられるセラミックグリーンシート2によって、分散性の悪さをある程度カバーできることもあるが、セラミックグリーンシート2の厚みが薄くなると、このようなセラミックグリーンシート2によって分散性をカバーする効果をほとんど期待することができない。

【0022】以上のことから、積層セラミックコンデンサの小型化かつ大容量化が進むほど、段差吸収用セラミックグリーン層5におけるセラミック粉末に関してより高い分散性が必要となってくる。

【0023】なお、混合工程におけるセラミック粉末の分散効率を高めるため、セラミックペーストの粘度を低くすることが考えられるが、このように粘度を低くするため、前述した低沸点の有機溶剤の添加量を増すと、分散処理後において、この低沸点の有機溶剤を除去するため、長時間必要とするという別の問題に遭遇する。

【0024】以上、積層セラミックコンデンサに関連して説明を行なったが、同様の問題は、積層セラミックコンデンサ以外のたとえば積層インダクタといった他の積層型セラミック電子部品においても遭遇する。

【0025】そこで、この発明の目的は、上述したような問題を解決し得る、積層型セラミック電子部品の製造方法およびこの製造方法によって得られた積層型セラミック電子部品を提供しようとすることである。

【0026】この発明の他の目的は、前述した段差吸収用セラミック層のように極めて薄いセラミックグリーン層を形成するのに適したセラミックペーストを製造する方法およびこの製造方法によって得られたセラミックペーストを提供しようとすることである。

【0027】

【課題を解決するための手段】この発明は、まず、積層型セラミック電子部品の製造方法に向けられる。この製造方法では、基本的に、次のような工程が実施される。

【0028】まず、セラミックスラリー、導電性ペーストおよびセラミックペーストがそれぞれ用意される。

【0029】次に、セラミックスラリーを成形することによって得られたセラミックグリーンシートと、セラミックグリーンシートの主面上にその厚みによる段差をもたらしように部分的に導電性ペーストを付与することによって形成された内部回路要素膜と、内部回路要素膜の厚みによる段差を実質的になくすようにセラミックグリーンシートの主面上であって内部回路要素膜が形成されない領域にセラミックペーストを付与することによって形成された段差吸収用セラミックグリーン層とを備える、複数の複合構造物が作製される。

【0030】次に、これら複数の複合構造物を積み重ねることによって、生の積層体が作製される。

【0031】そして、生の積層体が焼成される。

【0032】このような基本的工程を備える、積層型セ

ラミック電子部品の製造方法において、この発明では、段差吸収用セラミックグリーン層を形成するためのセラミックペーストを用意する工程、すなわちセラミックペーストを製造する方法に特徴がある。

【0033】この発明において、セラミックペーストを製造するため、少なくともセラミック粉末と第1の有機溶剤とを含む1次混合物を分散処理する1次分散工程と、1次分散工程を経た1次混合物に少なくとも有機バインダを加えた2次混合物を分散処理する2次分散工程とが実施される。ここで、有機バインダは、2次分散工程の段階において加えられることに注目すべきである。

【0034】また、この発明では、上述の第1の有機溶剤以外に、第1の有機溶剤より相対蒸発速度が小さい第2の有機溶剤が用いられることを特徴としている。この第2の有機溶剤は、1次分散工程の段階で加えられても、2次分散工程の段階で加えられても、あるいは、1次分散工程の段階で加えられながら、さらに2次分散工程の段階で追加されてもよい。すなわち、第2の有機溶剤は、1次混合物および/または2次混合物に含んでいる。

【0035】そして、最終的に、2次分散工程の後、2次混合物を加熱処理することによって、第1の有機溶剤を選択的に除去する除去工程が実施される。

【0036】上述したセラミックペーストの製造方法に含まれる1次分散工程において、1次混合物は有機分散剤を含むことが好ましい。

【0037】また、上述した第1の有機溶剤の20℃における相対蒸発速度は、100以上であり、第2の有機溶剤の20℃における相対蒸発速度は、50以下であることが好ましい。

【0038】また、セラミックペーストの製造方法において、2次分散工程の後であって、除去工程の前に、2次混合物を濾過する工程がさらに実施されることが好ましい。

【0039】また、セラミックペーストの製造方法において、有機バインダを第1の有機溶剤および/または第2の有機溶剤に溶解することによって、有機ビヒクルを作製する工程と、有機ビヒクルを濾過する工程とがさらに実施され、2次混合物は、濾過工程を経た有機ビヒクルの状態に加えられた有機バインダを含んでいることが好ましい。

【0040】また、セラミックペーストの製造方法において、第1および第2の有機溶剤として、前者の相対蒸発速度が後者の相対蒸発速度より大きくなるような組合せが選ばれるが、このことは、通常の場合、前者の沸点が後者の沸点より低くなる組合せを選ぶようにすれば、容易に実現できる。

【0041】上述したような沸点の差によって第1および第2の有機溶剤の組合せを選択する場合、第1の有機溶剤の沸点と第2の有機溶剤の沸点との差は、50℃以

上であることが好ましい。

【0042】この発明において、セラミックグリーンシートを成形するために用いられるセラミックスラリーは、段差吸収用セラミックグリーン層を形成するためのセラミックペーストに含まれるセラミック粉末と実質的に同じ組成を有するセラミック粉末を含むことが好ましい。

【0043】また、この発明の特定のな実施態様において、セラミックスラリーおよびセラミックペーストにそれぞれ含まれるセラミック粉末は、ともに、誘電体セラミック粉末である。この場合、内部回路要素膜が、互いの間に静電容量を形成するように配置される内部電極であるとき、積層セラミックコンデンサを製造することができる。

【0044】また、この発明の他の特定のな実施態様において、セラミックスラリーおよびセラミックペーストにそれぞれ含まれるセラミック粉末は、ともに、磁性体セラミック粉末である。この場合、内部回路要素膜が、コイル状に延びるコイル導体膜であるとき、積層インダクタを製造することができる。

【0045】この発明は、また、上述したような製造方法によって得られた、積層型セラミック電子部品にも向けられる。

【0046】また、この発明は、上述したようなセラミックペーストの製造方法およびこの製造方法によって得られたセラミックペーストにも向けられる。

【0047】

【発明の実施の形態】この発明の一実施形態の説明を、積層セラミックコンデンサの製造方法について行なう。この実施形態による積層セラミックコンデンサの製造方法は、前述した図1ないし図3を参照しながら説明することができる。

【0048】この実施形態を実施するにあたり、セラミックグリーンシート2のためのセラミックスラリー、内部電極1のための導電性ペーストおよび段差吸収用セラミックグリーン層5のためのセラミックペーストがそれぞれ用意される。

【0049】上述のセラミックスラリーは、誘電体セラミック粉末、有機バインダ、可塑剤および比較的低沸点の有機溶剤を混合することによって作製される。このセラミックスラリーからセラミックグリーンシート2を得るため、剥離剤としてのシリコーン樹脂等によってコーティングされた、たとえばポリエステルフィルムのような支持体(図示せず。)上で、セラミックスラリーがドクターブレード法等によって成形され、次いで乾燥される。セラミックグリーンシート2の各厚みは、乾燥後において、たとえば数 μm とされる。

【0050】上述のようなセラミックグリーンシート2の主面上には、複数箇所に分布するように、内部電極1が乾燥後においてたとえば約 $1\mu\text{m}$ の厚みをもって形成

される。内部電極1は、たとえば、スクリーン印刷等によって導電性ペーストを付与し、これを乾燥することによって形成される。この内部電極1は、それぞれ、所定の厚みを有して、したがって、セラミックグリーンシート2上には、この厚みによる段差がもたらされる。

【0051】次に、上述した内部電極1の厚みによる段差を実質的になくすように、セラミックグリーンシート2の主面上であって、内部電極1が形成されていない領域に、段差吸収用セラミックグリーン層5が形成される。段差吸収用セラミックグリーン層5は、内部電極1のネガティブパターンをもって、前述したセラミックペーストをスクリーン印刷等によって付与することにより形成され、次いで乾燥される。ここで用いられるセラミックペーストは、この発明において特徴となるもので、その詳細については後述する。

【0052】上述した説明では、内部電極1を形成した後に段差吸収用セラミックグリーン層5を形成したが、逆に、段差吸収用セラミックグリーン層5を形成した後に内部電極1を形成するようにしてもよい。

【0053】上述のように、セラミックグリーンシート2上に内部電極1および段差吸収用セラミックグリーン層5が形成された、図2に示すような複合構造物6は、複数用意され、これら複合構造物6は、支持体より剥離された後、適当な大きさに切断され、所定の枚数だけ積み重ねられ、さらにその上下に内部電極および段差吸収用セラミックグリーン層が形成されていないセラミックグリーンシートを積み重ねることによって、図1に一部を示すような生の積層体3aが作製される。

【0054】この生の積層体3aは、積層方向にプレスされた後、図3に示すように、個々の積層セラミックコンデンサのための積層体チップ4aとなるべき大きさに切断され、次いで、脱バインダ工程を経た後、焼成工程に付され、最終的に外部電極が形成されることによって、積層コンデンサが完成される。

【0055】上述のように、段差吸収用セラミックグリーン層5を形成することによって、図1に一部を示すように、生の積層体3aにおいて、内部電極1が位置する部分とそうでない部分との間、あるいは内部電極1が積層方向に比較的多数配列されている部分とそうでない部分との間での厚みの差が実質的に生じなくなり、図3に示すように、積層体チップ4aにおいて、不所望な変形が生じにくくなる。その結果、得られた積層セラミックコンデンサにおいて、デラミネーションや微小クラック等の構造欠陥およびショート不良といった問題を生じにくくすることができる。

【0056】この発明では、段差吸収用セラミックグリーン層5を形成するためのセラミックペーストを製造する方法に特徴があり、この特徴ある製造方法を採用することにより、セラミックペーストに含まれるセラミック粉末の分散性を高めることができる。

【0057】すなわち、この発明では、セラミックペーストを製造するため、少なくともセラミック粉末と第1の有機溶剤とを含む1次混合物を分散処理する1次分散工程と、この1次分散工程を経た1次混合物に少なくとも有機バインダを加えた2次混合物を分散処理する2次分散工程とが実施される。

【0058】このように、1次分散工程では、有機バインダを未だ加えていないので、低粘度下での分散処理が可能とし、そのため、セラミック粉末の分散性を高めることが容易である。この1次分散工程では、セラミック粉末の表面に吸着している空気が第1の有機溶剤で置換され、セラミック粉末を第1の有機溶剤で十分に濡らした状態とすることができるとともに、セラミック粉末の凝集状態を十分に解砕することができる。

【0059】また、2次分散工程では、上述のように、1次分散工程で得られたセラミック粉末の高い分散性を維持したまま、有機バインダを十分かつ均一に混合させることができ、また、セラミック粉末のさらなる粉砕効果も期待できる。

【0060】この発明では、上述の第1の有機溶剤以外に、第1の有機溶剤より相対蒸発速度が小さい第2の有機溶剤も用いられる。この第2の有機溶剤は、1次分散工程の段階で加えられても、2次分散工程の段階で加えられても、あるいは、1次分散工程の段階で加えられながら、2次分散工程の段階でも追加投入されてもよい。

【0061】そして、最終的に、2次分散工程の後、2次混合物を加熱処理することによって、第1の有機溶剤が選択的に除去される。

【0062】このように、第1の有機溶剤の除去が、2次分散工程の後に実施されるので、2次分散工程の段階においても、2次混合物の粘度を比較的低くしておくことが可能であり、したがって、分散効率を比較的高く維持しておくことができるとともに、前述したような2次分散工程の段階で加えられる有機バインダの溶解性を高めることができる。

【0063】上述のようにして得られたセラミックペーストは、有機溶剤としては、第1の有機溶剤がわずかに残存することがあっても、実質的に第2の有機溶剤のみを含んでいる。第2の有機溶剤は、第1の有機溶剤より相対蒸発速度が小さいため、セラミックペーストの乾燥速度を所定値以下に抑えることができ、たとえばスクリーン印刷を問題なく適用することを可能にする。

【0064】この発明において実施される1次分散工程および2次分散工程では、たとえばボールミルのようなメディアを用いる通常の分散処理機を適用して分散処理することができる。

【0065】この発明において、第1の有機溶剤または第2の有機溶剤として用いられる有機溶剤としては、種々のものがあり、このような有機溶剤の相対蒸発速度を考慮して、第1の有機溶剤として用いられるものおよび

第2の有機溶剤として用いられるものをそれぞれ選択すればよい。

【0066】このような有機溶剤の例としては、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン、アセトン等のケトン類、トルエン、ベンゼン、キシレン、ノルマルヘキサン等の炭化水素類、メタノール、エタノール、イソプロパノール、ブタノール、アミルアルコール等のアルコール類、酢酸エチル、酢酸ブチル、酢酸イソブチル等のエステル類、ジイソプロピルケトン、エチルセルソルブ、ブチルセルソルブ、セルソルブアセテート、メチルセルソルブアセテート、ブチルカルビトール、シクロヘキサノール、パイン油、ジヒドロテルピネオール、イソホロン、テルピネオール、シプロピレングリコール、ジメチルフタレート等のケトン類、エステル類、炭化水素類、アルコール類、塩化メチレン等の塩化炭化水素類、およびこれらの混合物が挙げられる。

【0067】より好ましくは、第1の有機溶剤としては、相対蒸発速度が100以上、さらに好ましくは150以上となる有機溶剤が選ばれる。除去工程での第1の有機溶剤の除去を速やかに終えるようにするためである。なお、相対蒸発速度とは、比較蒸発速度とも言い、25℃における酢酸ノルマルブチル（沸点126.5℃）の蒸発速度を100としたときの対象とする溶剤の相対的な蒸発速度を指す。相対蒸発速度の計算式は、
相対蒸発速度＝（酢酸ノルマルブチルの蒸発時間）／（対象溶剤の蒸発時間）×100
となり、蒸発時間は重量法によって測定する。

【0068】第1の有機溶剤に適した相対蒸発速度が100以上の有機溶剤としては、たとえば、メチルエチルケトン（相対蒸発速度465）、メチルイソブチルケトン（同145）、アセトン（同720）、トルエン（同195）、ベンゼン（同500）、メタノール（同370）、エタノール（同203）、イソプロパノール（同205）、酢酸エチル（同525）、酢酸イソブチル（同152）、酢酸ブチル（同100）、およびこれらの混合物が挙げられる。

【0069】他方、より好ましくは、第2の有機溶剤としては、20℃における相対蒸発速度が50以下となる有機溶剤が選択される。スクリーン印刷性を良好にするためである。

【0070】第2の有機溶剤に適した相対蒸発速度が50以下の有機溶剤としては、たとえば、ジイソプロピルケトン（相対蒸発速度49）、メチルセルソルブアセテート（同40）、セルソルブアセテート（同24）、ブチルセルソルブ（同10）、シクロヘキサノール（同10以下）、パイン油（同10以下）、ジヒドロテルピネオール（同10以下）、イソホロン（同10以下）、テルピネオール（同10以下）、シプロピレングリコール（同10以下）、ジメチルフタレート（同10以下）、ブチルカルビトール（同40以下）、およびこれらの混

合物が挙げられる。

【0071】なお、第1および第2の有機溶剤をそれぞれ選択するにあたって、上述のように相対蒸発速度によるのではなく、沸点によることも可能であり、むしろ沸点による方が、第1および第2の有機溶剤の各々の選択が容易である。沸点による場合、第1および第2の有機溶剤として、前者の沸点が後者の沸点より低くなる組合せを選ぶようにすれば、大体において、前者の相対蒸発速度が後者の相対蒸発速度より大きくなるような組合せを選び出すことができる。

【0072】前述した有機溶剤の例として挙げたもののいくつかについて、各々の沸点を括弧内に示すと、メチルエチルケトン（79.6℃）、メチルイソブチルケトン（118.0℃）、アセトン（56.1℃）、トルエン（111.0℃）、ベンゼン（79.6℃）、メタノール（64.5℃）、エタノール（78.5℃）、イソプロパノール（82.5℃）、酢酸エチル（77.1℃）、酢酸イソブチル（118.3℃）、ジイソプロピルケトン（143.5℃）、メチルセルソルブアセテート（143℃）、セルソルブアセテート（156.2℃）、ブチルセルソルブ（170.6℃）、シクロヘキサノール（160℃）、パイン油（195～225℃）、ジヒドロテルピネオール（210℃）、イソホロン（215.2℃）、テルピネオール（219.0℃）、シプロピレングリコール（231.8℃）、ジメチルフタレート（282.4℃）となるが、このような沸点に基づいて、第1および第2の有機溶剤をそれぞれ選択するようにすればよい。

【0073】上述したような沸点の差によって第1および第2の有機溶剤の組合せを選択する場合、第1の有機溶剤の沸点と第2の有機溶剤の沸点との差は、50℃以上であることが好ましい。除去工程において、加熱処理による第1の有機溶剤のみの選択的な除去をより容易にするためである。

【0074】上述した高沸点の第2の有機溶剤に関して、スクリーン印刷性を考慮したとき、150℃以上の沸点を有していることが好ましく、200～250℃程度の沸点を有していることがより好ましい。150℃未満では、セラミックペーストが乾燥しやすく、そのため、印刷パターンメッシュの目詰まりが生じやすく、他方、250℃を超えると、印刷塗膜が乾燥しにくく、そのため、乾燥に長時間要するためである。

【0075】セラミックペーストにおいて用いられる有機バインダとしては、室温で有機溶剤に溶解するものが良い。このような有機バインダとしては、たとえば、ポリビニルブチラール、ポリブチルブチラール等のポリアセタール類、ポリ（メタ）アクリル酸エステル類、エチルセルロース等の変性セルロース類、アルキッド類、ビニリデン類、ポリエーテル類、エポキシ樹脂類、ウレタン樹脂類、ポリアミド樹脂類、ポリイミド樹脂類、ポリ

アミドイミド樹脂類、ポリエステル樹脂類、ポリサルフォン樹脂類、液晶ポリマー類、ポリイミダゾール樹脂類、ポリオキサゾリン樹脂類等がある。

【0076】有機バインダとして上に例示したポリビニルブチラールは、ポリビニルアルコールとブチルアルデヒドとの縮合によって得られるものであり、アセチル基が6モル%以下で、ブチラール基が62～82モル%の低重合品、中重合品および高重合品がある。この発明に係るセラミックペーストにおいて有機バインダとして用いられるポリビニルブチラールは、有機溶剤に対する溶解粘度および乾燥塗膜の強靱性のバランスから、ブチラール基が65モル%程度の中重合品であることが好ましい。

【0077】有機バインダの添加量は、セラミック粉末に対して、1～20重量%、好ましくは、3～10重量%に選ばれる。

【0078】上述した1次分散工程において、1次混合物は有機分散剤を含むことが好ましい。すなわち、1次混合物において、第1の有機溶剤または第1および第2の有機溶剤によって希釈された状態で、有機分散剤を添加すれば、セラミック粉末の分散性がより向上する。

【0079】上述の有機分散剤としては、特に限定しないが、分散性の点からは、分子量は1万以下であることが好ましい。アニオン系、カチオン系、ノニオン系いずれでもよいが、ポリアクリル酸やそのアンモニウム塩、ポリアクリル酸エステル共重合体、ポリエチレンオキサイド、ポリオキシエチレンアルキルアミルエーテル、脂肪酸ジエタノールアמיד、ポリエチレンジイミン、ポリオキシプロピレンモノアリルモノブチルエーテルと無水マレイン酸（およびスチレン）の共重合体等が好ましい。

【0080】有機分散剤の添加量は、セラミック粉末に対して、0.1～5重量%、好ましくは、0.5～2.0重量%に選ばれる。

【0081】また、2次分散工程の後であって、除去工程の前に、2次混合物を濾過する工程がさらに実施されることが好ましい。これによって、セラミックペースト中に存在することがある、異物、セラミック粉末の凝集物、有機バインダの未溶解物等を除去することができ、より分散性の高いセラミックペーストを確実に得ることができる。また、セラミック粉末に付着しているような微小径の空気が濾過によって破泡したり除去されたりすることにより、セラミックペーストからなる段差吸収用セラミックグリーン層5の焼成後にもたらされるセラミック層においてピンホールを減少させる効果も期待できる。

【0082】あるいは、有機バインダを第1の有機溶剤および／または第2の有機溶剤に溶解することによって、有機ビヒクルを作製し、この有機ビヒクルを濾過した後、2次混合物において、濾過工程を経た有機ビヒク

ルの状態で有機バインダが加えられてもよい。

【0083】また、上述のような2つの態様の濾過は、各々、複数回繰り返してもよく、また、2つの態様の濾過を組み合わせてもよい。このように、濾過を複数回繰り返したり、2つの態様の濾過を組み合わせたことにより、濾過による効果を一層高めることができる。

【0084】上述した濾過工程においては、ステンレス鋼からなるフィルタ、またはポリプロピレン、フッ素系樹脂等のプラスチックからなるフィルタが用いられ、濾過速度を高めるため、空気や窒素ガス等の圧縮ガスによって強制的に押し出したり、減圧下で吸引したりする方法が採用されてもよい。

【0085】また、セラミックペーストに含まれるセラミック粉末は、セラミックグリーンシート2を成形するために用いられるセラミックスラリーに含まれるセラミック粉末と実質的に同じ組成を有するものであることが好ましい。段差吸収用セラミックグリーン層5とセラミックグリーンシート2との間で焼結性を一致させるためである。

【0086】なお、上述の実質的に同じ組成を有するとは、主成分が同じであるということである。たとえば、微量添加金属酸化物やガラス等の副成分が異なっても、実質的に同じ組成を有するということができる。また、セラミックグリーンシート2に含まれるセラミック粉末が、静電容量の温度特性についてJIS規格で規定するB特性およびEIA規格で規定するX7R特性を満足する範囲のものであれば、段差吸収用セラミックグリーン層5のためのセラミックペーストに含まれるセラミック粉末も、主成分が同じでB特性およびX7R特性を満足するものであれば、副成分が違っていてもよい。

【0087】図4は、この発明の他の実施形態としての積層インダクタの製造方法を説明するためのものであり、図5に外観を斜視図で示した、この製造方法によって製造された積層インダクタ11に備える積層体チップ12を得るために用意される生の積層体13を構成する要素を分解して示す斜視図である。

【0088】生の積層体13は、複数のセラミックグリーンシート14、15、16、17、…、18および19を備え、これらセラミックグリーンシート14～19を積層することによって得られるものである。

【0089】セラミックグリーンシート14～19は、磁性体セラミック粉末を含むセラミックスラリーを、ドクターブレード法等によって成形し、乾燥することによって得られる。セラミックグリーンシート14～19の各厚みは、乾燥後において、たとえば10～30μmとされる。

【0090】セラミックグリーンシート14～19のうち、中間に位置するセラミックグリーンシート15～18には、以下に詳細に説明するように、コイル状に延びるコイル導体膜および段差吸収用セラミックグリーン層

が形成される。

【0091】まず、セラミックグリーンシート15上には、コイル導体膜20が形成される。コイル導体膜20は、その第1の端部がセラミックグリーンシート15の端縁にまで届くように形成される。コイル導体膜20の第2の端部には、ビアホール導体21が形成される。

【0092】このようなコイル導体膜20およびビアホール導体21を形成するため、たとえば、セラミックグリーンシート15にビアホール導体21のための貫通孔をレーザまたはパンチングなどの方法により形成した後、コイル導体膜20およびビアホール導体21となる導電性ペーストを、スクリーン印刷等によって付与し、乾燥することが行なわれる。

【0093】また、上述したコイル導体膜20の厚みによる段差を実質的になくすように、セラミックグリーンシート15の主面上であって、コイル導体膜20が形成されていない領域に、段差吸収用セラミックグリーン層22が形成される。段差吸収用セラミックグリーン層22は、前述した、この発明において特徴となる磁性体セラミック粉末を含むセラミックペーストを、スクリーン印刷等によって付与し、乾燥することによって形成される。

【0094】次に、セラミックグリーンシート16上には、上述した方法と同様の方法によって、コイル導体膜23、ビアホール導体24および段差吸収用セラミックグリーン層25が形成される。コイル導体膜23の第1の端部は、前述したビアホール導体21を介して、コイル導体膜20の第2の端部に接続される。ビアホール導体24は、コイル導体膜23の第2の端部に形成される。

【0095】次に、セラミックグリーンシート17上には、同様に、コイル導体膜26、ビアホール導体27および段差吸収用セラミックグリーン層28が形成される。コイル導体膜26の第1の端部は、前述したビアホール導体24を介して、コイル導体膜23の第2の端部に接続される。ビアホール導体27は、コイル導体膜26の第2の端部に形成される。

【0096】上述したセラミックグリーンシート16および17の積層は、必要に応じて、複数回繰り返される。

【0097】次に、セラミックグリーンシート18上には、コイル導体膜29および段差吸収用セラミックグリーン層30が形成される。コイル導体膜29の第1の端部は、前述したビアホール導体27を介して、コイル導体膜26の第2の端部に接続される。コイル導体膜29は、その第2の端部がセラミックグリーンシート18の端縁にまで届くように形成される。

【0098】なお、上述したコイル導体膜20、23、26および29の各厚みは、乾燥後において、たとえば約30 μ m程度とされる。

【0099】このようなセラミックグリーンシート14～19をそれぞれ含む複数の複合構造物を積層して得られた生の積層体13において、各々コイル状に延びる複数のコイル導体膜20、23、26および29が、ビアホール導体21、24および27を介して順次接続されることによって、全体として複数ターンのコイル導体が形成される。

【0100】生の積層体13が焼成されることによって、図5に示す積層インダクタ11のための積層体チップ12が得られる。なお、生の積層体13は、図4では、1個の積層体チップ12を得るためのものとして図示されているが、複数の積層体チップを得るためのものとして作製され、これを切断することによって、複数の積層体チップを取り出すようにしてもよい。

【0101】次いで、図5に示すように、積層体チップ12の相対向する各端部には、前述したコイル導体膜20の第1の端部およびコイル導体膜29の第2の端部にそれぞれ接続されるように、外部電極30および31が形成され、それによって、積層インダクタ11が完成される。

【0102】図1ないし図3を参照して説明した積層セラミックコンデンサまたは図4および図5を参照して説明した積層インダクタ11において、セラミックグリーンシート2または14～19あるいは段差吸収用セラミックグリーン層5または22、25、28および30に含まれるセラミック粉末としては、代表的には、アルミナ、ジルコニア、マグネシア、酸化チタン、チタン酸バリウム、チタン酸ジルコン酸鉛、フェライトーマンガン等の酸化物系セラミック粉末、炭化ケイ素、窒化ケイ素、サイアロン等の非酸化物系セラミック粉末が挙げられる。粉末粒径としては、好ましくは、平均5 μ m以下、より好ましくは、1 μ mの球形または粉砕状のものが使用される。

【0103】また、不純物として含まれるアルカリ金属酸化物の含有量が0.1重量%以下のチタン酸バリウムをセラミック粉末として用いる場合、このセラミック粉末に対して、微量成分として以下のような金属酸化物やガラス成分を含有させてもよい。

【0104】金属酸化物としては、酸化テルビウム、酸化ジスプロシウム、酸化ホルミウム、酸化エルビウム、酸化イットリウム、酸化マンガン、酸化コバルト、酸化ニッケル、または酸化マグネシウム等がある。

【0105】また、ガラス成分としては、 $Li_2 - (SiTi)O_2 - MO$ (ただし、MOは Al_2O_3 または ZrO_2)、 $SiO_2 - TiO_2 - MO$ (ただし、MOはBaO、CaO、SrO、MgO、ZnOまたはMnO)、 $Li_2O - B_2O_3 - (SiTi)O_2 + MO$ (ただし、MOは Al_2O_3 または ZrO_2)、 $B_2O_3 - Al_2O_3 - MO$ (ただし、MOはBaO、CaO、SrOまたはMgO)、または SiO_2 等がある。

【0106】また、図1ないし図3を参照して説明した積層セラミックコンデンサまたは図4および図5を参照して説明した積層インダクタ11において、内部電極1またはコイル導体膜20、23、26および29ならびにビアホール導体21、24および27の形成のための用いられる導電性ペーストとしては、たとえば、次のようなものを用いることができる。

【0107】積層セラミックコンデンサにおいて用いられる導電性ペーストとしては、平均粒径が $0.02\mu\text{m}$ ～ $3\mu\text{m}$ 、好ましくは $0.05\sim0.5\mu\text{m}$ であって、 Ag/Pd が60重量%/40重量%～10重量%/90重量%の合金からなる導電性粉末、ニッケル金属粉末または銅金属粉末等を含み、この粉末を100重量部と、有機バインダを2～20重量部（好ましくは5～10重量部）と、焼結抑制剤としての Ag 、 Au 、 Pt 、 Ti 、 Si 、 Ni または Cu 等の金属レジネートを金属換算で約0.1～3重量部（好ましくは0.5～1重量部）と、有機溶剤を約35重量部とを、3本ロールで混練した後、同じまたは別の有機溶剤をさらに加えて粘度調整を行なうことによって得られた導電性ペーストを用いることができる。

【0108】積層インダクタ11において用いられる導電性ペーストとしては、 Ag/Pd が80重量%/20重量%～100重量%/0重量%の合金または Ag からなる導電性粉末を含み、この粉末が100重量部に対して、上述した積層セラミックコンデンサのための導電性ペーストの場合と同様の有機バインダと焼結抑制剤と有機溶剤とを同様の比率で3本ロールで混練した後、同じまたは別の有機溶剤をさらに加えて粘度調整を行なうことによって得られた導電性ペーストを用いることができる。

【0109】以下に、この発明を、実験例に基づいて、より具体的に説明する。

【0110】

【実験例1】実験例1は、積層セラミックコンデンサに関するもので、段差吸収用セラミックグリーン層のためのセラミックペーストの製造において、この発明の特徴としての1次分散工程と2次分散工程とを採用したことによる効果を確認するために実施したものである。

【0111】（セラミック粉末の準備）まず、炭酸バリウム（ BaCO_3 ）および酸化チタン（ TiO_2 ）を1：1のモル比となるように秤量し、ボールミルを用いて湿式混合した後、脱水乾燥させた。次いで、温度 1000°C で2時間仮焼した後、粉碎することによって、誘電体セラミック粉末を得た。

【0112】（セラミックスラリーの準備およびセラミックグリーンシートの作製）先に準備したセラミック粉末100重量部と、ポリビニルブチラール（中重合品）7重量部と、可塑剤としてDOP（フタル酸ジオクチル）3重量部と、メチルエチルケトン30重量部と、エ

タノール20重量部と、トルエン20重量部とを、直径1mmのジルコニア製玉石600重量部とともに、ボールミルに投入し、20時間湿式混合を行なって、セラミックスラリーを得た。

【0113】そして、このセラミックスラリーに対して、ドクターブレード法を適用して、厚さ $3\mu\text{m}$ （焼成後の厚みは $2\mu\text{m}$ ）のセラミックグリーンシートを成形した。乾燥は、 80°C で、5分間行なった。

【0114】（導電性ペーストの準備） $\text{Ag}/\text{Pd}=30/70$ の金属粉末100重量部と、エチルセルロース4重量部と、アルキッド樹脂2重量部と、 Ag 金属レジネート3重量部（ Ag として17.5重量部）と、ブチルカルビトールアセテート35重量部とを、3本ロールで混練した後、テルピネオール35重量部を加えて粘度調整を行なった。

【0115】（段差吸収用セラミックグリーン層のためのセラミックペーストの準備）

－試料1－

先に準備した誘電体セラミック粉末100重量部と、メチルエチルケトン（相対蒸発速度465）70重量部と、直径1mmのジルコニア製玉石600重量部とを、ボールミルに投入し、16時間湿式混合を行なった。次に、同じポットに、沸点 220°C のテルピネオール（相対蒸発速度10以下）40重量部と、エチルセルロース樹脂5重量部とを添加し、さらに、16時間混合することによって、セラミックスラリー混合物を得た。

【0116】次いで、上述のセラミックスラリー混合物を、 60°C の温浴中でエバポレータにより2時間減圧蒸留することにより、メチルエチルケトンを完全に除去して、セラミックペーストを得た。次いで、粘度調整用のために、テルピネオール10～20重量部添加して、自動乳鉢により分散・調整した。

【0117】－試料2－

先に準備した誘電体セラミック粉末100重量部と、メチルエチルケトン70重量部と、テルピネオール30重量部と、直径1mmのジルコニア製玉石600重量部とを、ボールミルに投入し、16時間湿式混合を行なった。次に、同じポットに、沸点 220°C のテルピネオール10重量部と、エチルセルロース樹脂5重量部とを添加し、さらに、16時間混合することによって、セラミックスラリー混合物を得た。

【0118】次いで、上述のセラミックスラリー混合物を、 60°C の温浴中でエバポレータにより2時間減圧蒸留することにより、メチルエチルケトンを完全に除去して、セラミックペーストを得た。次いで、粘度調整用のために、テルピネオール10～20重量部添加して、自動乳鉢により分散・調整した。

【0119】－試料3－

先に準備した誘電体セラミック粉末100重量部と、メチルエチルケトン70重量部と、ポリアクリル酸4級ア

ンモニウム塩分散剤(重量平均分子量1000)0.5重量部と、直径1mmのジルコニア製玉石600重量部とを、ボールミルに投入し、16時間湿式混合を行なった。次に、同じボットに、沸点220℃のテルピネオール10重量部と、エチルセルロース樹脂5重量部とを添加し、さらに、16時間混合することによって、セラミックスラリー混合物を得た。

【0120】次いで、上述のセラミックスラリー混合物を、60℃の温浴中でエバポレータにより2時間減圧蒸留することにより、メチルエチルケトン完全に除去して、セラミックペーストを得た。次いで、粘度調整用のために、テルピネオール10~20重量部添加して、自動乳鉢により分散・調整した。

【0121】-試料4-

先に準備した誘電体セラミック粉末100重量部と、沸点220℃のテルピネオール40重量部と、エチルセルロース樹脂5重量部とを、自動乳鉢で混合した後、3本ロールで良く混練して、セラミックペーストを得た。

【0122】(積層セラミックコンデンサの作製)先に用意したセラミックグリーンシートの主面上に内部電極を形成するため、導電性ペーストをスクリーン印刷し、80℃で10分間乾燥した。なお、内部電極の寸法、形状および位置は、後の工程で得られる積層体チップに適合するように設定した。次に、セラミックグリーンシートの主面上に段差吸収用セラミックグリーン層を形成するため、試料1ないし4に係る各セラミックペーストをスクリーン印刷し、80℃で10分間乾燥した。内部電極および段差吸収用セラミックグリーン層の各厚みは、乾燥後において、1μm(焼成後の厚みは0.5μm)になるようにした。

【0123】次に、上述のように内部電極および段差吸収用セラミックグリーン層を形成している200枚のセラミックグリーンシートを、内部電極等が付与されていない数10枚のセラミックグリーンシートで挟み込むように積み重ねて、生の積層体を作製し、この積層体を、80℃で1000Kg/cm²の加圧条件で熱プレスした。

【0124】次に、焼成後において長さ3.2mm×幅1.6mm×厚み1.6mmの寸法となるように、上述の生の積層体を切断刃にて切断することによって、複数の積層体チップを得た。

【0125】次に、ジルコニア粉末が少量散布された焼成用セッター上に、上述の複数の積層体チップを整列させ、室温から250℃まで24時間かけて昇温させ、有機バインダーを除去した。次に、積層体チップを、焼成炉に投入し、最高1300℃で約20時間のプロファイルにて焼成を行なった。

【0126】次に、得られた焼結体チップをバレルに投入し、端面研磨を施した後、焼結体の両端部に外部電極を設けて、試料となる積層セラミックコンデンサを完成

させた。

【0127】(特性の評価)上述した試料1ないし4に係るセラミックペーストおよび積層セラミックコンデンサについて、各種特性を評価した。その結果が表1に示されている。

【0128】

【表1】

| 試料番号 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|------------|-----|-----|------|-----|
| 固形分(wt%) | 65 | 64 | 66 | 67 |
| 粘度(Pa·s) | 9 | 8 | 10 | 12 |
| 分散度 | 0 | 0 | -0.2 | 0.3 |
| 印刷厚み(μm) | 4 | 4 | 3 | 5 |
| 限界粒径(μm) | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 1.5 |
| 構造欠陥不良率(%) | 2 | 3 | 0 | 80 |

【0129】表1における特性評価は、次のように行なった。

【0130】「固形分」：セラミックペースト約1gを精秤し、熱対流式オープンにおいて、150℃で3時間放置した後の重量から算出した。

【0131】「粘度」：セラミックペーストの粘度を、東京計器製E型粘度計を用いて、20℃において、2.5rpmの回転を付与して測定した。

【0132】「分散度」：セラミック粉末の粒度分布を光回折式粒度分布測定装置を用いて測定し、得られた粒度分布から算出した。すなわち、先に準備したセラミック粉末を、超音波ホモジナイザーを用いて水中で分散させ、粒経がこれ以上小さくならないところまで超音波を印加し、そのときのD90の粒経を記録して、これを限界粒経とした。他方、セラミックペーストをエタノール中で希釈し、粒度分布のD90の粒経を記録して、これをペーストの粒経とした。そして、
分散度=(ペーストの粒経/限界粒経)-1

の式に基づき、分散度を算出した。この分散度は、数値が+であれば、値が0に近いほど、分散性が良いことを示し、数値が-であれば、絶対値が大きいほど、分散性が良いことを示している。

【0133】「印刷厚み」：96%アルミナ基板上に、400メッシュで厚み50μmのステンレス鋼製スクリーンを用いて、乳剤厚み20μmで印刷し、80℃で10分間乾燥することにより、評価用印刷塗膜を形成し、その厚みを、比接触式のレーザ表面粗さ計による測定結果から求めた。

【0134】「Ra(表面粗さ)」：上記「印刷厚み」の場合と同様の評価用印刷塗膜を形成し、その表面粗さRa、すなわち、うねりを平均化した中心線と粗さ曲線との偏差の絶対値を平均化した値を、比接触式のレーザ表面粗さ計による測定結果から求めた。

【0135】「構造欠陥不良率」：得られた積層セラミックコンデンサのための焼結体チップの外観検査、超音波顕微鏡による検査で異常が見られた場合、研磨により

内部の構造欠陥を確認し、(構造欠陥のある焼結体チップ数) / (焼結体チップの総数) を構造欠陥不良率とした。

【0136】表1を参照すれば、1次分散工程と2次分散工程とを採用し、2次分散工程において有機バインダを添加した、試料1～3によれば、このようなことを行なわなかった試料4に比べて、優れた分散性を得ることができ、また、印刷厚み、表面粗さおよび構造欠陥不良率の各項目においても優れた結果を示していることがわかる。

【0137】

【実験例2】実験例2は、上記実験例1と同様、積層セラミックコンデンサに関するものであるが、段差吸収用セラミックグリーン層のためのセラミックペーストの製造において、濾過工程を付加したことによる効果を確認するために実施したものである。

【0138】以下の段差吸収用セラミックグリーン層のためのセラミックペーストの準備工程を除いて、前述した実験例1と同様の工程を実施して、積層セラミックコンデンサを作製した。

【0139】(段差吸収用セラミックグリーン層のためのセラミックペーストの準備)

—試料5—

実験例1における試料1の場合と同様の操作を経て得られたセラミックスラリー混合物を、絶対濾過 $20\mu\text{m}$ (99.7%の確率で $10\mu\text{m}$ 以上のものを除去できる)のフィルタによって加圧下で濾過した。

【0140】その後、実験例1における試料1の場合と同様の操作を経て、上述のセラミックスラリー混合物を処理して、セラミックペーストを得た。

【0141】—試料6—

上記試料5の場合において実施された絶対濾過 $20\mu\text{m}$ のフィルタによる濾過の後に、さらに、絶対濾過 $1\mu\text{m}$ のフィルタによって加圧下で濾過したことを除いて、試料5の場合と同様の操作を実施して、セラミックペーストを得た。

【0142】—試料7—

沸点 220°C のテルピネオール40重量部と、メチルエチルケトン10重量部と、エチルセルロース樹脂5重量部とを、プラネタリーミキサーにて混合することによって、エチルセルロース樹脂をテルピネオールおよびメチルエチルケトンに溶解させた有機ビヒクルを作製し、この有機ビヒクルを絶対濾過 $20\mu\text{m}$ のフィルタによって加圧下で濾過したものを用意した。

【0143】他方、先に準備した誘電体セラミック粉末100重量部と、メチルエチルケトン60重量部と、直径1mmのジルコニア製玉石600重量部とを、ボールミルに投入し、16時間湿式混合を行なった。

【0144】次に、同じボットに、前述のように予め用意された濾過後の有機ビヒクルを加え、さらに、16時間混合することによって、セラミックスラリー混合物を得た。

【0145】その後、実験例1における試料1の場合と同様の操作を経て、上述のセラミックスラリー混合物を処理して、セラミックペーストを得た。

【0146】—試料8—

上記試料7の場合において実施された絶対濾過 $20\mu\text{m}$ のフィルタによる濾過の後に、さらに、絶対濾過 $1\mu\text{m}$ のフィルタによって加圧下で濾過したことを除いて、試料7の場合と同様の操作を実施して、セラミックペーストを得た。

【0147】—試料9—

試料7の場合において実施された操作に加えて、試料5の場合において実施されたセラミックスラリー混合物の濾過をさらに実施することによって、セラミックペーストを得た。

【0148】上述した試料5ないし9に係るセラミックペーストおよび積層セラミックコンデンサについて、各種特性を評価した結果が、表2に示されている。

【0149】

【表2】

| 試料番号 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----------------------|------|------|-----|-----|------|
| 固形分(wt%) | 66 | 67 | 66 | 67 | 68 |
| 粘度(Pa·s) | 10 | 12 | 15 | 14 | 16 |
| 分散度 | -0.1 | -0.2 | 0 | 0 | -0.3 |
| 印刷厚み(μm) | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 粗さ(μm) | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.2 |
| 構造欠陥不良率(%) | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 0 |

【0150】表2における特性評価方法は、表1の場合と同様である。

【0151】表2における試料5は、表1における試料1と比較して、セラミックスラリー混合物を濾過している点でのみ異なっているので、試料5を試料1と比較すれば、濾過による効果を確認することができる。すなわち、試料5によれば、試料1に比べて、より優れた分散

性を得ることができ、また、印刷厚み、表面粗さおよび構造欠陥不良率の各項目においても優れた結果を示している。

【0152】また、表2において、試料5と試料6との比較、試料7と試料8との比較、あるいは、試料5または7と試料9との比較をそれぞれ行なうと、濾過工程に関して、これを複数回行なったり、異なる態様の濾過を

組み合わせたりすることにより、汙過による効果を一層高め得ることがわかる。

【0153】

【実験例3】実験例3は、上記実験例1および2と同様、積層セラミックコンデンサに関するものであるが、段差吸収用セラミックグリーン層のためのセラミックペーストの製造において用いられる第1および第2の有機溶剤の各々についての相対蒸発速度の好ましい範囲を確認するために実施したものである。

【0154】以下に記載する、段差吸収用セラミックグリーン層のためのセラミックペーストの準備工程を除いて、前述した実験例1と同様の工程を実施して、積層セラミックコンデンサを作製した。

【0155】（段差吸収用セラミックグリーン層のためのセラミックペーストの準備）

—試料10—

実験例1における試料1と比較して、第1の有機溶剤として、相対蒸発速度が100の酢酸ノルマルブチルを用いたことを除いて、試料1の場合と同様の操作を経て、セラミックペーストを作製した。

【0156】—試料11—

実験例1における試料1と比較して、第1の有機溶剤として、相対蒸発速度が720のアセトンを用いたことを除いて、試料1の場合と同様の操作を経て、セラミックペーストを作製した。

【0157】—試料12—

実験例1における試料1と比較して、第1の有機溶剤として、相対蒸発速度が83のイソブチルアルコールを用いたことを除いて、試料1の場合と同様の操作を経て、セラミックペーストを作製した。

【0158】—試料13—

実験例1における試料1と比較して、第1の有機溶剤として、相対蒸発速度が370のメタノールを用い、かつ、第2の有機溶剤として、相対蒸発速度が55のメチルセルソルブを用いたことを除いて、試料1の場合と同様の操作を経て、セラミックペーストを作製した。

【0159】上述した試料10ないし13に係るセラミックペーストおよび積層セラミックコンデンサについて、用いた第1および第2の有機溶剤の種類および各種特性を評価した結果が、表3に示されている。

【0160】

【表3】

| 試料番号 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 第1の有機溶剤 (相対蒸発速度) | 酢酸ノルマルブチル (100) | アセトン (720) | イソブチルアルコール (83) | メタノール (370) |
| 第2の有機溶剤 (相対蒸発速度) | テルピネオール (10以下) | テルピネオール (10以下) | テルピネオール (10以下) | メチルセルソルブ (55) |
| 蒸発時間(Hr) | 2 | 1 | 4 | 蒸発がいつまでも 止まらない |
| 固形分(wt%) | 70 | 87 | 66 | — |
| 粘度(Pa·s) | 15 | 9 | 10 | — |
| 分散性 | 0.2 | 0 | 0.4 | — |
| Ra(μm) | 0.1 | 0.5 | 1.0 | — |
| 構造欠陥不良率(%) | 3 | 2 | 10 | — |

【0161】表3において、「蒸発時間」は、減圧蒸留開始時から有機溶剤（通常、第1の有機溶剤）が蒸発しなくなるまでの時間を示したものである。表3におけるその他の特性についての評価方法は、表1の場合と同様である。

【0162】表3を参照して、第1の有機溶剤として、相対蒸発速度が100以上のものを用い、かつ、第2の有機溶剤として、相対蒸発速度が50以下のものを用いられた、試料10および11によれば、第1の有機溶剤の蒸発を迅速に終わることができるとともに、分散性、表面粗さおよび構造欠陥不良率の点でも好ましい結果を得ることができる。

【0163】これに対して、第2の有機溶剤の相対蒸発速度は50以下であるが、第1の有機溶剤の相対蒸発速度が100未満である、試料12では、第1の有機溶剤を迅速に蒸発させることができず、また、分散性、表面粗さおよび構造欠陥不良率の点においても、試料10および11に比べて劣っている。

【0164】また、第1の有機溶剤の相対蒸発速度は100以上であるが、第2の有機溶剤の相対蒸発速度が50を超える、試料13では、第2の有機溶剤についての蒸発が長時間続き、たとえば、スクリーン印刷を実施している間にセラミックペーストの乾燥が進むため、スクリーンの目詰まり等を生じ、良好なスクリーン印刷を達成することが困難になる。

【0165】

【実験例4】実験例4は、積層インダクタに関するもので、段差吸収用セラミックグリーン層のためのセラミックペーストの製造において、この発明の特徴としての1次分散工程と2次分散工程とを採用したことによる効果を確認するために実施したものである。

【0166】（セラミック粉末の準備）酸化第二鉄が49.0モル%、酸化亜鉛が29.0モル%、酸化ニッケルが14.0モル%、および酸化銅が8.0モル%となるように秤量し、ボールミルを用いて湿式混合した後、脱水乾燥させた。次いで、750℃で1時間仮焼した

後、粉碎することによって、磁性体セラミック粉末を得た。

【0167】(セラミックスラリーの準備およびセラミックグリーンシートの作製) 先に準備した磁性体セラミック粉末100重量部と、ポリビニルブチラール(中重合品)7重量部と、可塑剤としてDOP(フタル酸ジオクチル)3重量部と、メチルエチルケトン30重量部と、エタノール20重量部と、トルエン20重量部とを、直径1mmのジルコニア製玉石600重量部とともに、ボールミルに投入し、20時間湿式混合を行なった、セラミックスラリーを得た。

【0168】そして、このセラミックスラリーに対して、ドクターブレード法を適用して、厚さ20 μ m(焼成後の厚みは15 μ m)のセラミックグリーンシートを成形した。乾燥は、80℃で、5分間行なった。

【0169】(導電性ペーストの準備) Ag/Pd=70/30の金属粉末100重量部と、エチルセルロース4重量部と、アルキッド樹脂2重量部と、Ag金属レジネート3重量部(Agとして17.5重量部)と、ブチルカルビトールアセテート35重量部とを、3本ロールで混練した後、テルピネオール35重量部を加えて粘度調整を行なった。

【0170】(段差吸収用セラミックグリーン層のためのセラミックペーストの準備)

一試料14-

先に準備した磁性体セラミック粉末100重量部と、メチルエチルケトン(相対蒸発速度465)70重量部と、直径1mmのジルコニア製玉石600重量部とを、ボールミルに投入し、16時間湿式混合を行なった。次に、同じポットに、沸点220℃のテルピネオール(相対蒸発速度10以下)40重量部と、エチルセルロース樹脂5重量部とを添加し、さらに、16時間混合することによって、セラミックスラリー混合物を得た。

【0171】次いで、上述のセラミックスラリー混合物を、60℃の温浴中でエバポレータにより2時間減圧蒸留することにより、メチルエチルケトンを完全に除去して、セラミックペーストを得た。次いで、粘度調整用のために、テルピネオール10~20重量部添加して、自動乳鉢により分散・調整した。

【0172】一試料15-

先に準備した磁性体セラミック粉末100重量部と、メチルエチルケトン70重量部と、テルピネオール30重量部と、直径1mmのジルコニア製玉石600重量部とを、ボールミルに投入し、16時間湿式混合を行なった。次に、同じポットに、沸点220℃のテルピネオール10重量部と、エチルセルロース樹脂5重量部とを添加し、さらに、16時間混合することによって、セラミックスラリー混合物を得た。

【0173】次いで、上述のセラミックスラリー混合物を、60℃の温浴中でエバポレータにより2時間減圧蒸

留することにより、メチルエチルケトンを完全に除去して、セラミックペーストを得た。次いで、粘度調整用のために、テルピネオール10~20重量部添加して、自動乳鉢により分散・調整した。

【0174】一試料16-

先に準備した磁性体セラミック粉末100重量部と、メチルエチルケトン70重量部と、ポリアクリル酸4級アンモニウム塩分散剤(重量平均分子量1000)0.5重量部と、直径1mmのジルコニア製玉石600重量部とを、ボールミルに投入し、16時間湿式混合を行なった。次に、同じポットに、沸点220℃のテルピネオール10重量部と、エチルセルロース樹脂5重量部とを添加し、さらに、16時間混合することによって、セラミックスラリー混合物を得た。

【0175】次いで、上述のセラミックスラリー混合物を、60℃の温浴中でエバポレータにより2時間減圧蒸留することにより、メチルエチルケトンを完全に除去して、セラミックペーストを得た。次いで、粘度調整用のために、テルピネオール10~20重量部添加して、自動乳鉢により分散・調整した。

【0176】一試料17-

先に準備した磁性体セラミック粉末100重量部と、沸点220℃のテルピネオール40重量部と、エチルセルロース樹脂5重量部とを、自動乳鉢で混合した後、3本ロールで良く混練して、セラミックペーストを得た。

【0177】(積層インダクタの作製) 複数の磁性体セラミックグリーンシートの積層後にコイル状に延びるコイル導体が形成できるように、先に用意した磁性体セラミックグリーンシートの所定の位置に、ビアホール導体のための貫通孔を形成するとともに、磁性体セラミックグリーンシートの主面上にコイル導体膜および貫通孔内にビアホール導体を形成するため、導電性ペーストをスクリーン印刷し、80℃で10分間乾燥した。次に、磁性体セラミックグリーンシート上に、段差吸収用磁性体セラミックグリーン層を形成するため、試料14ないし17に係る各磁性体セラミックペーストをスクリーン印刷し、80℃で10分間乾燥した。コイル導体膜および段差吸収用磁性体セラミックグリーン層の各厚みは、乾燥後において、30 μ m(焼成後の厚みは20 μ m)になるようにした。

【0178】次に、上述のようにコイル導体膜およびビアホール導体ならびに段差吸収用セラミックグリーン層を形成している11枚の磁性体セラミックグリーンシートを、コイル導体が形成されるように重ねるとともに、その上下にコイル導体膜等を形成していない磁性体セラミックグリーンシートを重ねて、生の積層体を作製し、この積層体を、80℃で1000Kg/cm²の加圧下で熱プレスした。

【0179】次に、焼成後において長さ3.2mm×幅1.6mm×厚み1.6mmの寸法となるように、上述

の生の積層体を切断刃にて切断することによって、複数の積層体チップを得た。

【0180】次に、上述の積層体チップを400℃で2時間加熱することによって、有機バインダを除去した後、900℃で90分間の焼成を行なった。

【0181】次に、得られた焼結体チップをバレルに投入し、端面研磨を施した後、焼結体の両端部に主成分が銀である外部電極を設けて、試料となるチップ状の積層インダクタを完成させた。

【0182】(特性の評価) 上述した試料14ないし17に係るセラミックペーストおよび積層インダクタについて、各種特性を評価した結果が表4に示されている。

【0183】

【表4】

| 試料番号 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|------------|-----|-----|------|-----|
| 固形分(wt%) | 72 | 73 | 72 | 73 |
| 粘度(Pa·s) | 15 | 14 | 11 | 18 |
| 分散度 | 0 | 0 | -0.3 | 0.2 |
| 印刷厚み(μm) | 20 | 21 | 19 | 19 |
| Ra(μm) | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 1.6 |
| 構造欠陥不良率(%) | 1 | 1 | 0 | 50 |

【0184】表4における特性評価方法は、表1の場合と同様である。

【0185】表4を参照すれば、表1に示した実験例1の場合と同様、1次分散工程と2次分散工程とを採用し、2次分散工程において有機バインダを添加した、試料14～16によれば、このようなことを行なわなかった試料17に比べて、優れた分散性を得ることができ、また、印刷厚み、表面粗さおよび構造欠陥不良率の各項目においても優れた結果を示していることがわかる。

【0186】以上、この発明に係るセラミックペーストに含まれるセラミック粉末として、誘電体セラミック粉末または磁性体セラミック粉末が用いられる場合について説明したが、この発明では、用いられるセラミック粉末の電気的特性に左右されるものではなく、したがって、たとえば、絶縁体セラミック粉末あるいは圧電体セラミック粉末等を用いても、同様の効果を期待できるセラミックペーストを得ることができる。

【0187】

【発明の効果】以上のように、この発明によれば、セラミックペーストを製造するにあたって、少なくともセラミック粉末と第1の有機溶剤とを含む1次混合物を分散処理する1次分散工程と、1次分散工程を経た1次混合物に少なくとも有機バインダを加えた2次混合物を分散処理する2次分散工程と、第1の有機溶剤より相対蒸発速度が小さい第2の有機溶剤を1次混合物および/または2次混合物に含ませる工程と、2次分散工程の後、2次混合物を加熱処理することによって、第1の有機溶剤を選択的に除去する除去工程とが実施されるので、セラミックペーストに含まれるセラミック粉末の分散性を優

れたものとするができる。そのため、極めて薄いセラミックグリーン層を、高いパターン精度をもって形成しなければならない場合において、このようなセラミックペーストを有利に用いることができる。

【0188】したがって、この発明によれば、積層型セラミック電子部品において、内部回路要素膜の厚みによる段差を実質的になくすようにセラミックグリーンシートの主面上であって内部回路要素膜が形成されない領域に段差吸収用セラミックグリーン層を形成するために、上述のようなセラミックペーストが用いられることによって、クラックやデラミネーション等の構造欠陥のない信頼性の高い積層型セラミック電子部品を実現することができる。

【0189】また、この発明によれば、積層型セラミック電子部品の小型化かつ軽量化の要求に十分に対応することが可能となり、この発明が積層セラミックコンデンサに適用された場合、積層セラミックコンデンサの小型化かつ大容量化を有利に図ることができ、また、この発明が積層インダクタに適用された場合、積層インダクタの小型化かつ高インダクタンス化を有利に図ることができる。

【0190】上述した1次分散工程において、1次混合物に有機分散剤を含ませるようにすると、セラミック粉末の分散性をより向上させることができる。

【0191】また、上述した第1の有機溶剤の20℃における相対蒸発速度が100以上とされ、第2の有機溶剤の20℃における相対蒸発速度が50以下とされると、除去工程での第1の有機溶剤の除去を速やかに終えることができるとともに、スクリーン印刷性を良好にすることができる。

【0192】また、2次分散工程の後であって、除去工程の前に、2次混合物を濾過する工程をさらに実施したり、有機バインダを第1の有機溶剤および/または第2の有機溶剤に溶解することによって、有機ビヒクルを作製し、この有機ビヒクルを濾過した後、2次混合物に含ませるようにしたりすれば、セラミックペースト中に存在することがある、異物、セラミック粉末の凝集物、有機バインダの未溶解物等を除去することができ、より分散性の高いセラミックペーストを確実に得ることができる。また、焼成後のセラミック層においてピンホールを減少させる効果も期待できる。

【0193】また、第1および第2の有機溶剤として、前者の相対蒸発速度が後者の相対蒸発速度より大きくなるような組合せを選ぶため、前者の沸点が後者の沸点より低くなる組合せを選ぶようにすれば、第1および第2の有機溶剤の選択が容易になる。

【0194】上述したような沸点の差によって第1および第2の有機溶剤の組合せを選択する場合、第1の有機溶剤の沸点と第2の有機溶剤の沸点との差を、50℃以上とすることにより、除去工程において、加熱処理によ

る第1の有機溶剤のみの選択的な除去をより容易にすることができる。

【0195】また、この発明に係る積層型セラミック電子部品の製造方法において、セラミックグリーンシートを成形するために用いられるセラミックスラリーが、段差吸収用セラミックグリーン層を形成するためのセラミックペーストに含まれるセラミック粉末と実質的に同じ組成を有するセラミック粉末を含むようにすると、セラミックグリーンシートと段差吸収用セラミックグリーン層との焼結性を一致させることができ、このような焼結性の不一致によるクラックやデラミネーションの発生を防止することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】この発明にとって興味ある、かつこの発明の一実施形態による、積層セラミックコンデンサの製造方法を説明するためのもので、生の積層体3 aの一部を図解的に示す断面図である。

【図2】図1に示した積層セラミックコンデンサの製造方法において作製される複合構造物6の一部を破断して示す平面図である。

【図3】図1に示した積層セラミックコンデンサの製造方法において作製される積層体チップ4 aを図解的に示す断面図である。

【図4】この発明の他の実施形態による積層インダクタを製造するために用意される生の積層体1 3を構成する

要素を分解して示す斜視図である。

【図5】図4に示した生の積層体1 3を焼成して得られた積層体チップ1 2を備える積層インダクタ1 1の外観を示す斜視図である。

【図6】この発明にとって興味ある従来の積層セラミックコンデンサの製造方法を説明するためのもので、生の積層体3の一部を図解的に示す断面図である。

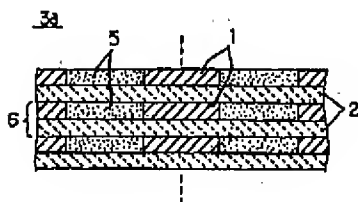
【図7】図6に示した積層セラミックコンデンサの製造方法において作製される内部電極1が形成されたセラミックグリーンシート2の一部を示す平面図である。

【図8】図6に示した積層セラミックコンデンサの製造方法において作製される積層体チップ4を図解的に示す断面図である。

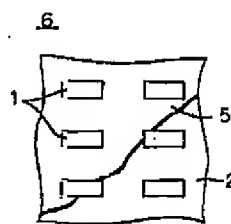
【符号の説明】

- 1 内部電極（内部回路要素膜）
- 2, 14～19 セラミックグリーンシート
- 3 a, 13 生の積層体
- 4 a, 12 積層体チップ
- 5, 22, 25, 28, 30 段差吸収用セラミックグリーン層
- 6 複合構造物
- 11 積層インダクタ（積層型セラミック電子部品）
- 20, 23, 26, 29 コイル導体膜（内部回路要素膜）

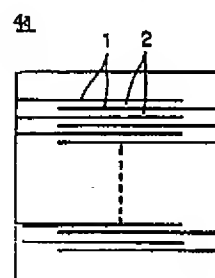
【図1】



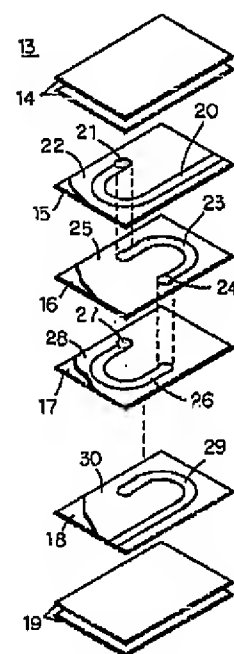
【図2】



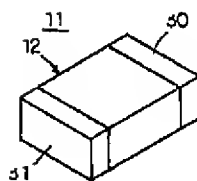
【図3】



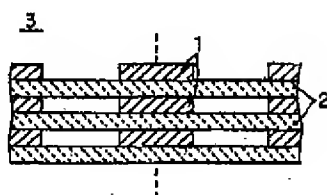
【図4】



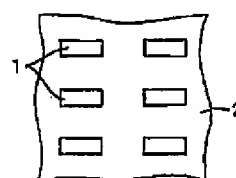
【図5】



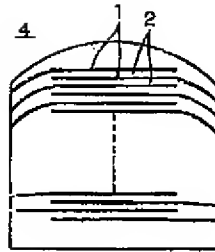
【図6】



【図7】



【図8】



フロントページの続き

| (51)Int.Cl. ⁷ | 識別記号 | FI | (参考) |
|--------------------------|-------|--------------|--------|
| C 04 B 35/622 | | H 01 F 41/04 | C |
| H 01 F 17/00 | | H 01 G 4/30 | 3 01 E |
| 41/04 | | | 3 11 F |
| H 01 G 4/30 | 3 0 1 | C 04 B 35/00 | J |
| | 3 1 1 | | D |